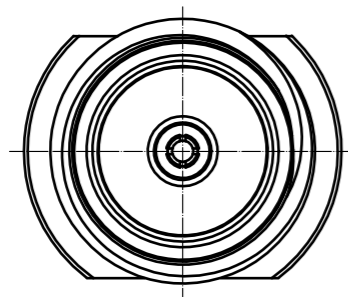
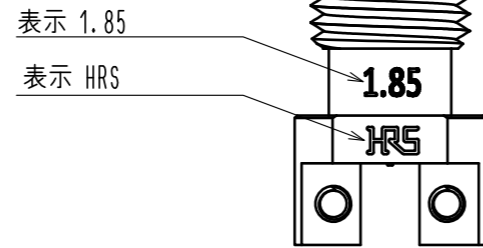


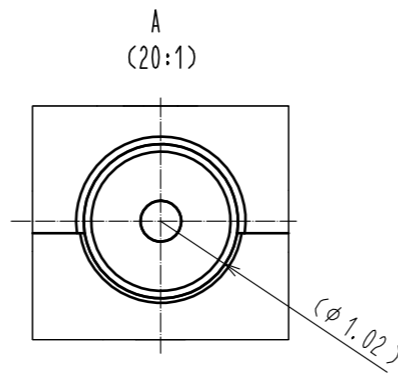
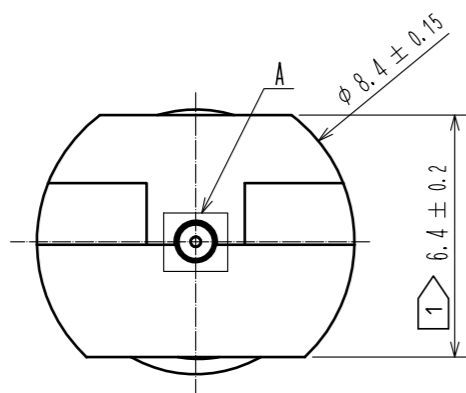
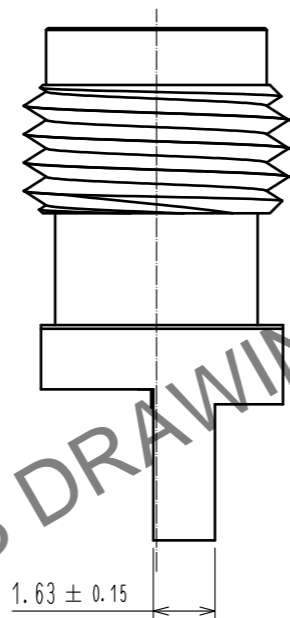
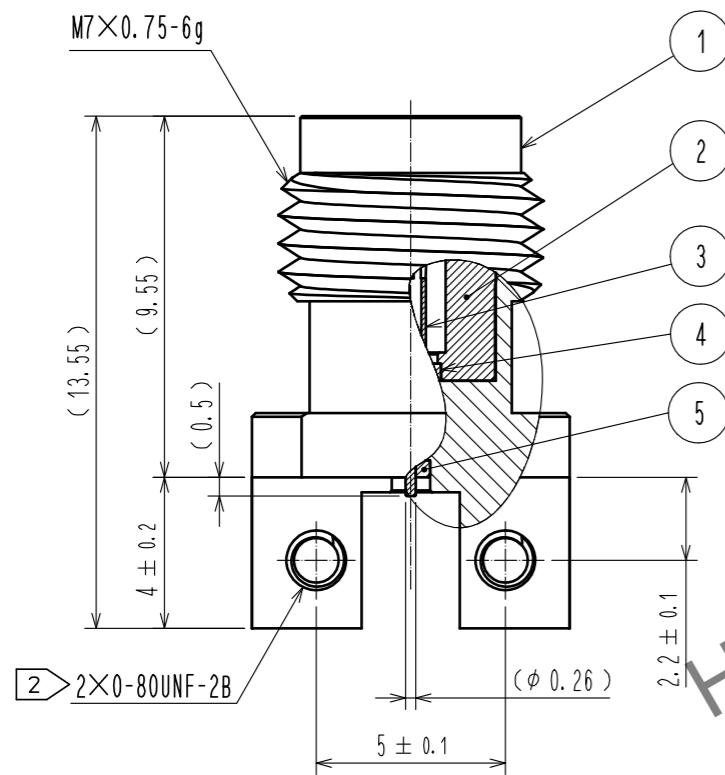
Feb.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



(3:1)

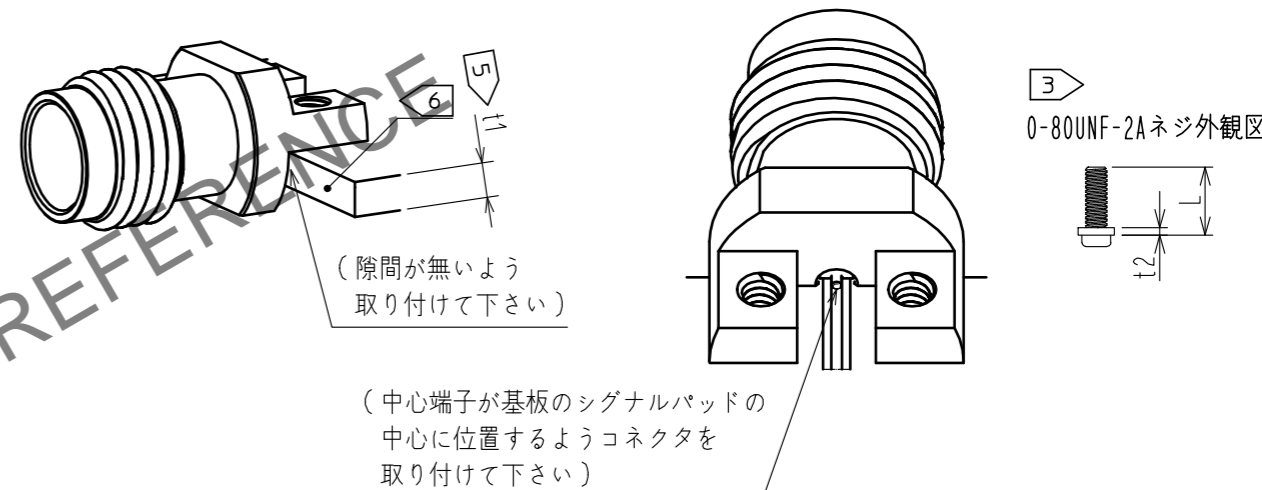


- 注 ① 嵌合を行う際は、基板実装部へのトルクによる負荷をかけないように、
 6.4±0.2フライズ部をスパナ等で保持して下さい。
 ② 0-80UNF-2Bねじの基板への推奨締付けトルクは0.09N・mとなります。片側ずつ交互均等に締めていき
 最後に両側を増し締めして下さい。
 ③ コネクタ取付に使用するねじの長さLは、基板厚さt1(mm)＋ね座金厚さt2(mm)＋1.8mmのものをご使用下さい。
 ④ 図示する推奨寸法は誘電率3.6、厚みt=0.2の基板材での条件となります。ランドパターン形状は基材の誘電率、
 板厚、層構成に依存します。コネクタを含めたPCBレイアウトの高周波解析を推奨します。
 ⑤ 推奨基板厚は、t1=1.0mm以上です。
 ⑥ 基板端面はサイドめっき処理を推奨します。
 ⚠ 7. 高速伝送基板を測定する試作評価用のはんだレス実装コネクタとなり、製品へ搭載してのご使用は推奨しておりません。

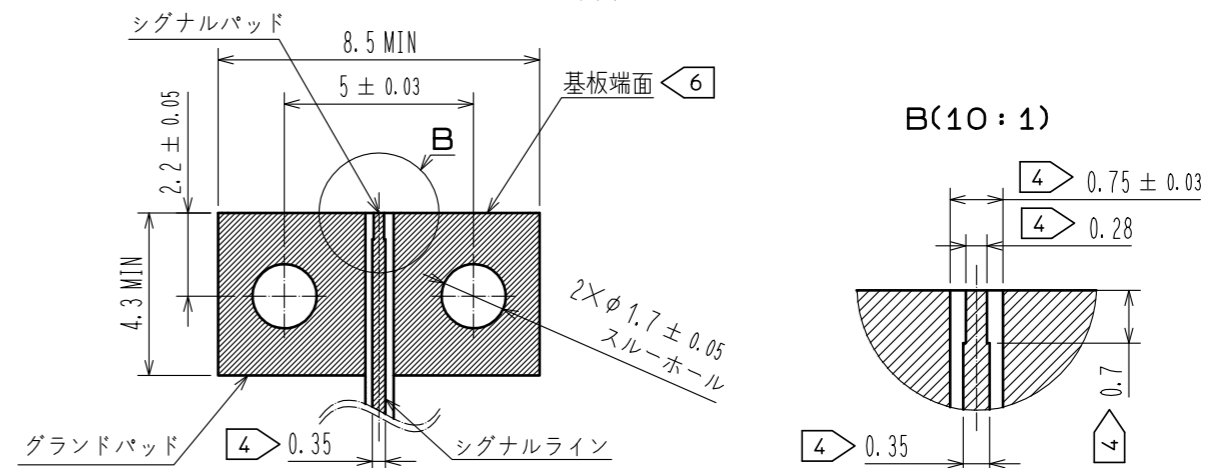


コネクタの実装について

- (1) コネクタを基板へ実装する際は、基板端面とコネクタとの間に隙間のないようにして下さい。
 (2) コネクタの中心端子が基板のシグナルパッドの中心に位置するように取り付けて下さい。



推奨ランドパターン図



シグナルパッド及び指示部のランドパッドにはレジストを施さないで下さい。

2	ステンレス鋼	バッシベイト	5	PEI樹脂	
1	黄銅	金めっき	4	PEI樹脂	
			3	ベリリウム銅	金めっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS	mm	SCALE	5 : 1	COUNT	1
DESCRIPTION OF REVISIONS			DESIGNED	RO. YOKOYAMA	CHECKED
DIS-D-00016663			DATE	20230818	
APPROVED : TS. NOBE			20190823	DRAWING NO.	
CHECKED : NK. NINOMIYA			20190822	ADC-384075-00-00	
DESIGNED : AH. MARUYAMA			20190821	PART NO.	
DRAWN : AH. MARUYAMA			20190821	HV-LR-SR2	
CODE NO.				CL0338-0018-0-00	
					1/1